

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成26年10月9日(2014.10.9)

【公開番号】特開2013-229489(P2013-229489A)

【公開日】平成25年11月7日(2013.11.7)

【年通号数】公開・登録公報2013-061

【出願番号】特願2012-101297(P2012-101297)

【国際特許分類】

H 0 1 L 25/00 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 25/00 A

【手続補正書】

【提出日】平成26年8月21日(2014.8.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 プリント基板と、

電線と、前記電線の両端を露出させつつ前記電線を覆う被膜を有し、前記電線の一端が前記第 1 プリント基板に接続されたフラットケーブルと、

前記電線の他端と接続された第 2 プリント基板と、を備え、

前記フラットケーブルは、前記第 1 プリント基板と前記第 2 プリント基板を対向させるように屈曲しており、

前記被膜の一部には平坦面が形成されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

前記被膜は熱可塑性樹脂で形成されたことを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 3】

前記平坦面は前記電線と略直交する方向に伸びる細長い形状であることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 4】

絶縁基板と、

前記絶縁基板の上に形成された半導体素子と、

一端が前記半導体素子と電氣的に接続され、他端が前記第 1 プリント基板に電氣的に接続された導線を備えたことを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の半導体装置。

【請求項 5】

前記半導体素子と接続されたワイヤと、

前記ワイヤと接続された中継端子と、を備え、

前記導線の一端は前記中継端子と接続されたことを特徴とする請求項 4 に記載の半導体装置。

【請求項 6】

前記導線の一端は前記半導体素子と接続されたことを特徴とする請求項 4 に記載の半導体装置。

【請求項 7】

前記導線は、フラットケーブル又はボンディングワイヤであることを特徴とする請求項

4乃至6のいずれか1項に記載の半導体装置。

【請求項8】

電線の両端を露出させつつ前記電線を覆う被膜を有するフラットケーブルの前記被膜に、平坦面を形成する工程と、

平坦な吸着面を有する吸着器の前記吸着面を前記平坦面に当てて、前記吸着器で前記フラットケーブルを保持しつつ移動させ、前記フラットケーブルの一端を第1プリント基板に接続し他端を第2プリント基板に接続する工程と、

前記フラットケーブルを折り曲げて前記第1プリント基板と前記第2プリント基板を対向させる工程と、を備えたことを特徴とする半導体装置の製造方法。